



GlobalWafers 社による Siltronic 社との事業統合契約の締結のお知らせ

- GlobalWafers 社と Siltronic 社の事業統合により、半導体用シリコンウェーハ業界のグローバル・リーダーが誕生。
- Siltronic 社普通株式 1 株につき 125 ユーロの公開買付価格は、2020 年 11 月 27 日に開示された「GlobalWafers 社と Siltronic 社による買収交渉の進展」のプレスリリースの直前 90 日間のフランクフルト証券取引所 (Xetra) における売買高加重平均価格 (VWAP) に対して、48%のプレミアム。
- GlobalWafers 社は、Siltronic 社の発行済株式の全てを対象とした公開買付け (Voluntary Takeover Offer) を実施。
- Wacker Chemie 社 (Siltronic 社の筆頭株主) は、GlobalWafers 社と公開買付けに係る応募契約を同時に締結。保有する Siltronic 社株式 30.8%を全て GlobalWafers 社に売却。
- 公開買付けの総額は、Siltronic 社の発行済株式の全てに対して 37 億 5000 万ユーロ。

台湾・新竹 2020 年 12 月 10 日 — GlobalWafers 株式会社 (6488.TWO) (以下「GlobalWafers 社」) と Siltronic AG (FRA: WAF) (以下「Siltronic 社」) は、両社ともに半導体用シリコンウェーハの製造販売におけるリーダーであり、本日ここに事業統合契約 (以下「本事業統合契約」) を締結したこと、及び GlobalWafers 社が Siltronic 社の全ての発行済株式を取得するための公開買付け (以下「本公開買付け」) を行うことを公表します。

本事業統合契約は、GlobalWafers 社と Siltronic 社の事業統合後の両社共通の戦略的なビジョンを実現し、両社の統合を成功に導くための協力的なフレームワークを規定するものです。GlobalWafers 社と Siltronic 社は、この事業統合によって、以下を含む数多くの戦略・事業運営上のメリットが生まれることを期待しています。

- さらなる生産能力拡大のためのリソースの拡充
- 増え続ける需要に応えるための生産力・技術力の向上
- 統合されたリソースの多様性により、より臨機応変な生産が可能に
- 財務力と事業運営力の飛躍的な向上
- 株主や顧客に対する有意義なシナジーと価値創造の可能性
- 地理的な事業領域と、顧客ベースの多様性の拡大



本公開買付けに応募する Siltronic 社の株主は、普通株式 1 株につき 125 ユーロを現金で受け取ることができます。この公開買付け価格は、GlobalWafers 社と Siltronic 社による買収交渉の進展のプレスリリースの直前 90 日間のフランクフルト証券取引所 (Xetra) における売買高加重平均価格 (VWAP) に対して 48% のプレミアムとなり、また同開示前の Siltronic 社の直前取引日となった 2020 年 11 月 27 日の普通株式終値に対して 10% のプレミアムとなっています。Siltronic 社の執行役員会は、その配当政策に沿う形で、2020 年度分として Siltronic 社 1 株当たり約 2 ユーロの配当を次の年次株主総会に提案する予定です。この配当は、本事業統合の完了の前に支払われることとなる見込みです。

本公開買付けは、Siltronic 社の発行済株式総数に対して 65% 以上の最低買付株式数の応募を含むクロージングの前提条件の充足と、規制当局の承認が条件となります。本事業統合契約は、GlobalWafers 社取締役会と、Siltronic 社執行役員会及び監査役会により承認されています。

本事業統合の一部として、Siltronic 社の筆頭株主である Wacker Chemie 社は、GlobalWafers 社との間で公開買付けに対する応募契約を締結しています。本応募契約は、Wacker Chemie 社が対抗ビッド (公開買付け) にその応募を転じることを禁止し、その保有する全ての Siltronic 社株式 30.8% 相当を GlobalWafers 社による本公開買付けに応募するものです。

本公開買付けは、ドイツ連邦金融監督庁 (BaFin) による認可が受領され次第開始される予定です。公開買付け期間は、2020 年 12 月から開始され、5 週間ほどになる見込みです。なお、公開買付け期間は、本公開買付けの諸条件と、関連する法制度に従い、延長される可能性があります。

Siltronic 社の持つ技術力や同社の従業員は、統合後の事業で重要な役割を果たすと期待されており、GlobalWafers 社も様々な条件を本事業統合契約において合意しました。例えば (1) Siltronic 社の Burghausen 事業所を Siltronic 社の事業における主要な研究開発ハブとして維持すること、(2) 既存のウェーハ生産ライン維持に必要な設備投資を確保すること、(3) 少なくとも 2024 年末まではドイツ国内において、Siltronic 社の施設の閉鎖または従業員の解雇をしないこと、などが含まれています。

GlobalWafers 社は、本公開買付けの資金として、DBS 銀行からの買収ローンを充当します。本公開買付け完了直後のプロ・フォーマの財務レバレッジは、プロ・フォーマ EBITDA に対するネット有利子負債の倍率が約 2.6 倍となります (Siltronic 社株式 100% を全て取得したと仮定)。本公開買付けは、そのクロージング直後に GlobalWafers 社の一株当たり利益 (EPS) の増加が見込まれます。



GlobalWafers 社会長兼 CEO の Doris Hsu (徐 秀蘭) は、次のようにコメントしています。
「今回の取引は、GlobalWafers 社と Siltronic 社の 2 社だけでなく、お客様や株主、その他のステークホルダーすべての方々にとって有益になるものと信じております。本事業統合は、半導体用シリコンウェーハ業界における世界的なリーディング・プレイヤーを誕生させ、世界中の半導体メーカーの顧客に技術的に優れた製品を供給することができる網羅的な製品ポートフォリオを構築し、相互補完的なスキルとリソースを両社が持ち寄ることとなり、統合された事業はさらなる生産能力の拡大に投資することができるでしょう。」

アドバイザー

GlobalWafers 社の単独財務アドバイザーは野村證券、法務アドバイザーは Linklaters LLP と White & Case LLP が担当しています。

GlobalWafers 社の概要

台湾の新竹市に本社を持つ GlobalWafers 社は、世界のトップ 5 に入る半導体用シリコンウェーハ・メーカーです。1981 年に設立され、当初は SAS 社 (Sino-American Silicon Products Inc.) の半導体事業部でしたが、2011 年にスピンオフをして GlobalWafers 社となりました。3~12 インチのシリコンウェーハ製造に特化し、製品は電力マネジメント、自動車、IT、MEMS など幅広い領域で使用されています。GlobalWafers 社は台北証券取引所に上場しています。

お問い合わせ先

GlobalWafers 社広報 IR 担当 : William Chen +886-3-577-2255 (ext. [2280])

重要なお知らせ:

本発表は、Siltronic 社の株式の取得の申込みではなく、売付けの申込みの勧誘でもありません。Siltronic AG の株主に対する買付者による公開買付オファーに関する条件および追加規定は、ドイツ連邦金融監督庁 (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) による発行承認後に公表される買付説明書に記載されません。Siltronic 社の株式の保有者は、買付説明書を読み、適切な場合には、当該書類に記載された事項に関して独立した助言を求めることが強く推奨されます。また、本発表は、GlobalWafers Co., Ltd. の株式の売付けの申込みではなく、取得の申込みの勧誘でもありません。

ドイツ連邦共和国以外の特定の法域における本発表の公開、公表又は配布は、法律によって制限される場合があります。他の法域に居住しているか、その法域に服する者は、適用される要件を認識し、遵守しなければなりません。

当該公開買付オファーは、1934 年米国証券取引法第 14 条 (e) 及び同法に基づくルール 14 d-1 (d) により免除されている同法に基づくレギュレーション 14 E に依拠し、これに準拠して、アメリカ合衆国において行われます。



適用ある法令で許容される範囲において、かつ、ドイツの市場慣行に従い、買付者、その関係会社及び／又は買付者を代理するブローカーは、米国外において、かつ、適用ある法律を遵守し、Siltronic社の株式又はSiltronic社の株式に直ちに転換可能、交換可能又は権利行使可能な有価証券に関する一定の買付（公開買付オファーによるものを除きます。）を、公開買付オファーが受け入れ可能な期間の前、期間中又は後に、直接又は間接的に随時行い又は行う手配をする場合があります。当該買付は、一般市場において実勢価格で行われ、又は非公開の取引において交渉された価格で行われる場合があります。当該買付に関する情報は、ドイツ又はその他関連する法域における法令に定めるところにより開示されます。

本発表には、GlobalWafers Co., Ltd. 及び／若しくはその子会社（以下、合わせて「GlobalWafersグループ」といいます。）又は、Siltronic AG 及び／若しくはその子会社（以下、合わせて「Siltronicグループ」といいます。）の「将来予想に関する記述」であるもの、又は「将来予想に関する記述」となりうるものを含む可能性があります。将来予想に関する記述には、典型的には、「予想する」、「目標とする」、「期待する」、「見込む」、「意図する」、「計画する」、「信じる」、「望む」、「目指す」、「継続する」、「であろう」、「かもしれない」、「すべきである」、「したいと思う」、「できる」又はこれらに類似する意味を持つ他の言葉が含まれますが、これらに限られません。将来予想に関する記述は、その性質として、様々な事象に関連しており、将来起こりうる、又は起こらない可能性もある状況に依拠するため、リスク及び不確実性を含みます。将来予想に関する記述は、かかる将来の事象が発生すること又は将来の業績を保証するものではなく、特に、実際の業績、財務状況及び流動性、GlobalWafersグループ及びSiltronicグループが事業を展開する業界の成長並びに買収による結果又は影響を保証するものではなく、また、GlobalWafersグループ及び／又はSiltronicグループに関連する事項については、本発表に含まれる将来予想に関する記述においてなされたもの、又は示唆されたものと実質的に異なる可能性があることを、GlobalWafers Co., Ltd. 及び買付者は警告いたします。将来の業績に関する記述は、本発表日現在のみのもので言及されています。適用法令で定められている場合を除き、GlobalWafers Co., Ltd. 及び買付者は、新たな情報、将来の事象、又はその他の結果にかかわらず、将来予想に関する記述を公に更新又は改訂する義務を負いません。